			客户代码 000 线图号			LDV DV 000 740 A				
地拉斯 CHIZH	华宇电子科技股イ OU HISEMI ELECTRONICS TEC 纸 Bonding Diagr	Customer No. 产品名称	Customer No. UVO Drawing No. 产品名称 US 5146 M3			HY-PX-008-748 A 封装外型				
	近径(um) 焊线根数 Diameter NO. of wire	Zam 焊线总长(μm) Total wire length	Product Type 最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm)	塑封料型	PKG Type 号(绿色环保) l Type (Green)	 	LF载体尺	寸	
合金丝 Ag	20 20	42247	2570	1443	首选(Preferred): E 备选(Optional):		TSSOP20L-8R (1 (3000X4200um²)	LF Pad Si 18X165mil ²		
客户图号 Customer drawing NO.	1	1		1	ar 26 (Opdona).		(3000X4200din-)			
	•	6								
20	19 1	8 17	16	15	14	13	12	11		
	T F	Z F	19			15	5			
								 注 /:	意使用	引线弧
					18.				_	
1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10)	
框架传送方向(装片): L/F Direction(D/A):		实物图: Chip phot	o:	7,10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	8	特殊说明 Special Ins DB注意: 芯片居中放置并逆 WB注意:				
椭圆孔·						1.数字为不打线pad	l点个数;			
说明 粘片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否是 Low-K If low-k?	减薄厚度 (µm) Wafer Thickness
A芯: DIE A P电胶 (conductivity) S502	DB4	1364*922(um²) 53.70*36.30(mil²)	50*50	98	2	是/Yes	60	8	否/N0	200
B芯: DIE B										
C.芯:										
DIE C 拟制 Prepared by	2k - 1111x	制图日期 Create Date	2024,	/4/25	生效日期 Effective Date				签字/盖: Signature	μ:
研发审核 R&D Check	302- 4:05	产品工程审核 PE Check			批准 Approved by					
179	生产的唯一依据,请您认真 only basis for the production of t		签后的图纸生产, firm it carefully Our	如图纸错误会产生 company will produ		谢! rding to the drawings	you have signed bac	k, such as	页码	Page
drawing mistakes, which will pre	oduce inestimable loss. Thank yo	ou		,, produ		- G.		, no	1.,	/ 1